

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿6丁目24番1号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090305000
2009年3月31日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎

データシート訂正(UCCx732x製品)のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

一 記 一

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	<input checked="" type="checkbox"/> Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 項の記載訂正 現行 : Analog Input & Output Voltage 項目の記載 変更後 : Analog Input & Output Voltage 項目の記載訂正			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	データシート訂正是3月中旬に実施済みです。 4月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。
 発行済みのデータシートに訂正箇所がありその訂正をお知らせするものです。弊社 PWR(パワーマネジメント) UCCx732x製品について、製品の変更は一切ありませんが、製品特性をより反映する為にデータシートの記載訂正を実施しました。更新済のデータシートについては、下記webを参照ください。
 尚、今回の変更で訂正対象項目を除き、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

理由：製品特性をより反映する為

対象製品リスト

対象製品名

UCC27323D	UCC27324DGN	UCC27325DGNR	UCC37323DR	UCC37324P
UCC27323DG4	UCC27324DGNG4	UCC27325DGNRG4	UCC37323DRG4	UCC37324PE4
UCC27323DGN	UCC27324DGNR	UCC27325DR	UCC37323P	UCC37325D
UCC27323DGNG4	UCC27324DGNG4	UCC27325DRG4	UCC37323PE4	UCC37325DG4
UCC27323DGNR	UCC27324DR	UCC27325P	UCC37324D	UCC37325DGN
UCC27323DGNG4	UCC27324DRG4	UCC27325PE4	UCC37324DG4	UCC37325DGNG4
UCC27323DR	UCC27324P	UCC37323D	UCC37324DGN	UCC37325DGNR
UCC27323DRG4	UCC27324PE4	UCC37323DG4	UCC37324DGNG4	UCC37325DGNRG4
UCC27323P	UCC27325D	UCC37323DGN	UCC37324DGNR	UCC37325DR
UCC27323PE4	UCC27325DG4	UCC37323DGNG4	UCC37324DGNRG4	UCC37325DRG4
UCC27324D	UCC27325DGN	UCC37323DGNR	UCC37324DR	UCC37325P
UCC27324DG4	UCC27325DGNG4	UCC37323DGNRG4	UCC37324DRG4	UCC37325PE4

詳細：

1. Datasheet#

SLUS492E ⇒ SLUS492F

<http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27324.pdf>

Item	Page/Location	Description of Change
C.1	Pg. 3, Analog Input & Output Voltage “ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS” table	Added these parameters & their specs limits to the maximum rating table

C1 Pg. 3, Analog Input & Output Voltage "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" table

absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)†‡

Supply voltage, V_{DD}	-0.3 V to 16 V
Output current (OUTA, OUTB)	DC, I_{OUT_DC} 0.2 A
	Pulsed, (0.5 μ s), I_{OUT_PULSED} 4.5 A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (DGN package)	3 W
	(D package) 650 mW
	(P package) 350 mW
Junction operating temperature, T_J	-55°C to 150°C
Storage temperature, T_{stg}	-65°C to 150°C
Lead temperature (soldering, 10 sec.),	300°C

[†] Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

† All voltages are with respect to GND. Currents are positive into, negative out of the specified terminal



absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)†‡

Supply voltage, V_{DD}	-0.3 V to 16 V
Analog input (IN), and output voltage (OUTA, OUTB)	-0.3 V to $V_{DD} + 0.3$ V, not to exceed 16 V
Output current (OUTA, OUTB) DC, I_{OUT_DC}	0.2 A
	Pulsed, (0.5 μ s), I_{OUT_PULSED} 4.5 A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ (DGN package)	3 W
	(D package) 650 mW
	(P package) 350 mW
Junction operating temperature, T_J	-55°C to 150°C
Storage temperature, T_{stg}	-65°C to 150°C
Lead temperature (soldering, 10 sec.),	300°C

[†] Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

\dagger All voltages are with respect to GND. Currents are positive into, negative out of the specified terminal.